

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

公告编号：2025-041

芯联集成电路制造股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项

获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 15 名交易对方合计持有的芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司 72.33% 股权（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 7 月 18 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意芯联集成电路制造股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2025〕1502 号）。批复文件的主要内容如下：

“一、同意你公司向绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 454,009,900 股股份、向深圳市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 181,603,960 股股份、向厦门辰途华辉创业投资合伙企业（有限合伙）发行 139,229,702 股股份、向厦门辰途华明创业投资基金合伙企业（有限合伙）发行 136,202,970 股股份、向厦门辰途华景创业投资基金合伙企业（有限合伙）发行 75,668,316 股股份、向珠海横琴强科二号股权投资合伙企业（有限合伙）发行 60,534,653 股股份、向张家港毅博企业管理中心（有限合伙）发行 60,534,653 股股份、向尚融创新（宁波）股权投资中心（有限合伙）发行 60,534,653 股股份、向井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业（有限合伙）发行 30,267,326 股股份、向华民科文（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）发行 30,267,326 股股份、向无锡芯朋微电子股份有限公司发行 30,267,326 股股份、向广东导远科技有限公司发行 24,213,861 股股份、向广东辰途十六号创业投资合伙企业（有限合伙）发行 16,041,683 股股份、向广州辰途十五号创业投资基金合伙企业（有限合伙）发

行 8,172,178 股股份、向锐石创芯（重庆）科技股份有限公司发行 6,053,465 股股份购买相关资产的注册申请。

二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送上海证券交易所的有关申请文件进行。

三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

五、本批复自下发之日起 12 个月内有效。

六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

公司董事会将根据批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次交易所涉及的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2025 年 7 月 19 日